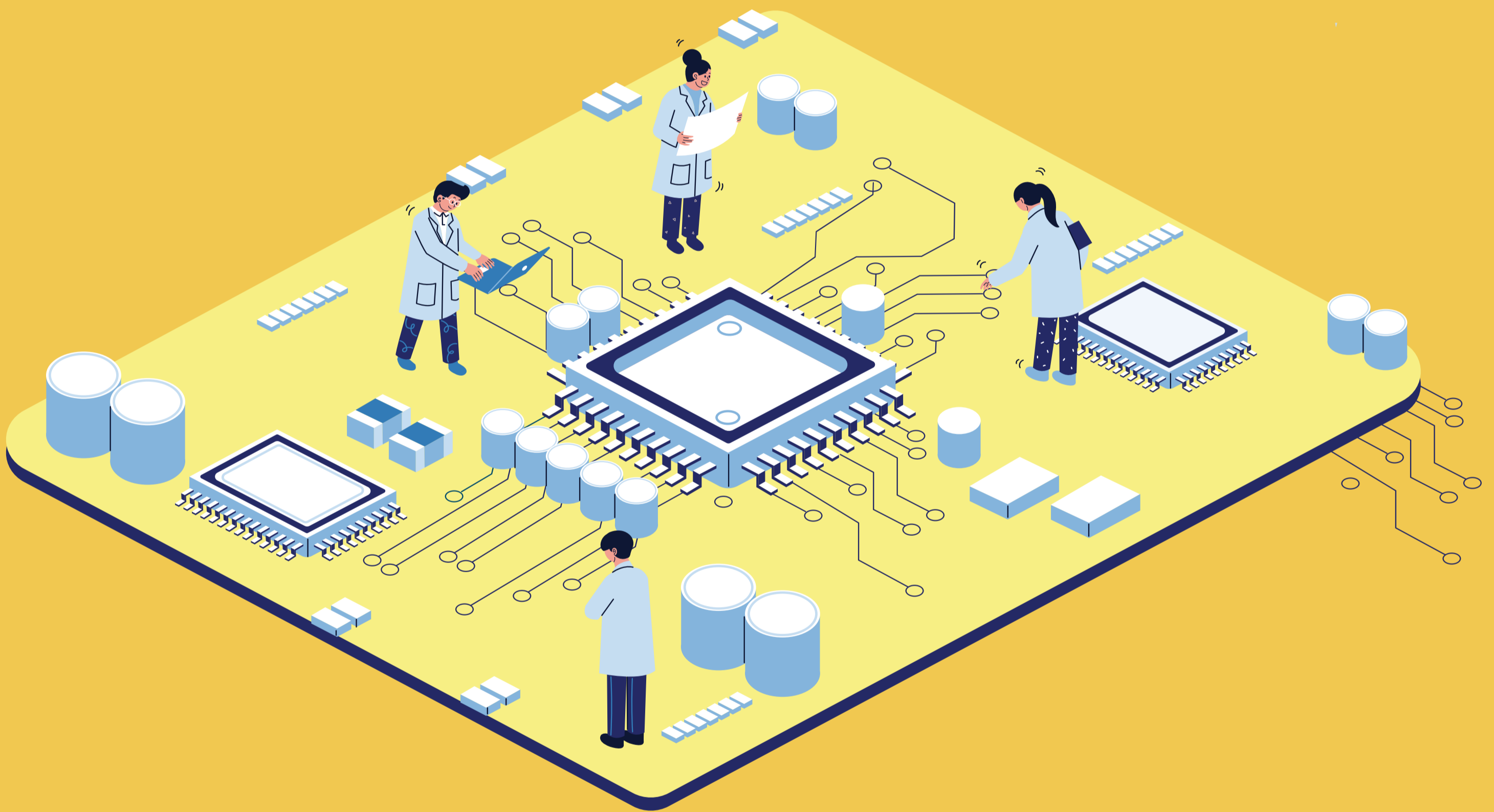


미래 반도체의 중심에서, 인재의 미래를 설계하다

2026학년도 반도체특성화대학지원사업 연계전공 참여학생 모집



모 집 개 요

- 참여학과: 반도체공학과, 기계공학과, 기계자동차공학부, 미래자동차공학과, 전자공학과, 전자융합공학부, 신소재공학과, 전자재료공학과, 로봇공학과, 지능로봇학과, 컴퓨터공학부
- 지원자격: 연계전공 참여학과 3학년·4학년 재학생(2026학년도 기준)
- 모집일정: 2025.11.04.(화) ~ 모집 시 까지
- 모집인원: 65명
- 접수방법: awdx1530@hoseo.edu 이메일 접수

2026학년도

반도체특성화대학지원사업 연계전공 참여학생 모집

참여 혜택

- 장학금(등록금 외 지급) 최대 420만원/년* + 추가장학금 **

| 구분 | 장학금 | 몰입학기 장학금 | | 합계 |
|---------------------|--|---|---|-------------------|
| 금액 | 100만원~150만원/학기 | 40~60만원/학기 | | 최대 420만원 /년 |
| 지급 조건 | *** 학기별 연계전공 교과목 1개 이상 이수 사업단 프로그램 마일리지 구간별 차등지급 | '26학년도 하계/동계방학 중 호서대학교에서 개설된 계절학기 이수 학생 | '26학년도 하계/동계방학 중 대학 간 공동교육과정 이수 학생 (명지대학교 개설) | |
| * 몰입학기 장학금은 중복수혜 불가 | | | | |

- ※ 장학금 규모와 지급조건은 반도체특성화대학지원사업 예산에 따라 추후 조정될 수 있음
- ※※ 연1회 개최되는 성과 경진대회 입상자에 대해 추가 장학금 지급
- ※※※ 재학기간 내 복수전공 취득을 위한 자격조건을 충족해야 하며, 미 충족시 지급된 장학금을 환수할 수 있음

- 사업단 비교과 프로그램 및 글로벌 연수(미국 및 베트남 등) 우선 선발 및 추천

교육과정

반도체 첨단 패키징 분야의 전문 교육과정별 신청

| 연계전공 | 모집인원 | 이수구분 | 참여학과 | |
|-----------|------------|------|------------|--|
| 반도체패키지공정 | 65명 내 외 | 복수전공 | 반도체 공학과 | 기계자동차공학부, 기계공학과, 미래자동차공학과, 로봇공학과, 지능로봇학과, 전자공학과, 전자융합공학부 |
| 반도체패키지설계 | | | | 전자공학과, 전자융합공학부, 기계자동차공학부, 기계공학과, 미래자동차공학과 |
| 반도체패키지재료 | | | | 신소재공학과, 전자재료공학과 |
| 반도체패키지신뢰성 | | | | 전자공학과, 전자융합공학부, 컴퓨터공학부 |

※ 이수학점: 교육과정적용년도 [~23학번: 32학점 /24학번~: 33학점]

문의사항

- 소속학부(과) 학부(과)장님께 문의
- 반도체특성화사업단 오현숙 041)540-9865 / awdx1530@hoseo.edu